

Une pâte à braser à forte conductivité thermique pour l'industrie aérospatiale

Pour faciliter la dissipation thermique de l'électronique embarquée, notamment dans les satellites, le Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux a mis au point une pâte à braser qui permet l'assemblage des composants en garantissant une bonne évacuation de la chaleur. Le nouveau produit breveté est commercialisé par la société Inventec.

[Lire l'article](#)